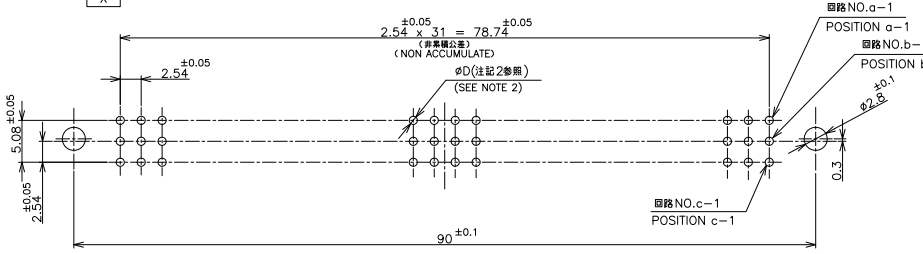
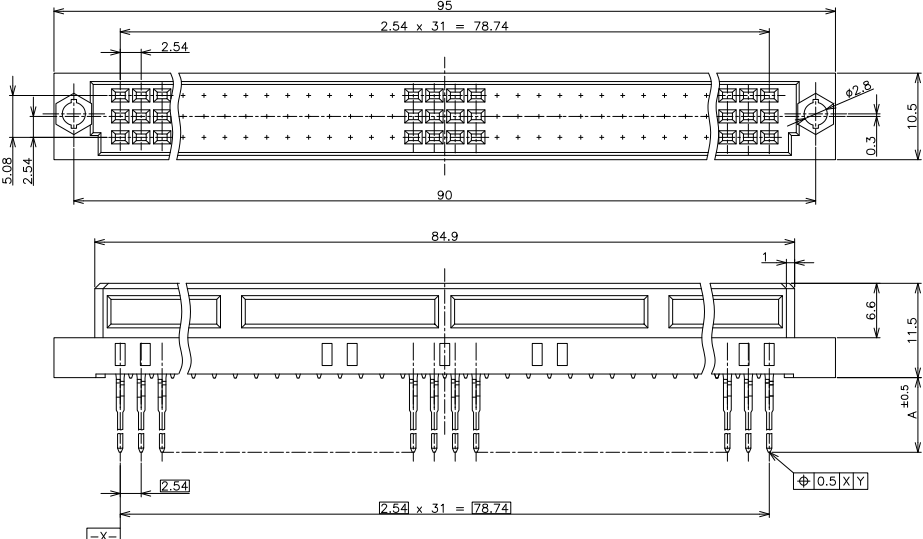
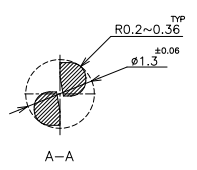
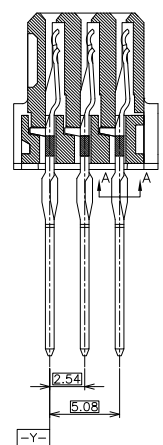


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION NOV. 2004.
 © COPYRIGHT 2004 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.



P.C. BOARD LAYOUT DIMENSIONS
 プリント基板 製作寸法
 (コネクタ搭載面)
 (CONN. MOUNTING SIDE)

REV	DATE	BY	APP'D
0	30NOV04	T.K	K.J
01	09NOV09	KK	AEG



- 材料 : コンタクト: 銅合金
 パラシタ: 難可溶性バリエタル樹脂 (灰色)
- アクションピンの適合基板仕様
 材質 : NEMA等級G10ガラスファイバー入りエポキシ又は類似品
 厚さ : 1.6mm~3.2mm
 スルーホール径 (φD)
 下穴径 : 1.15±0.025
 肉厚残存 : 0.025~0.075(健康: 150μm最大)
 銅めっき層の厚さ : 0.04~0.010
 めっき後の穴径 : 0.94~1.09
 銅リフロー後の柱上穴径 : 0.91~1.09

- MATERIAL : CONT: COPPER ALLOY
 HSG: POLYESTER(GRAY)
 - P.C. BOARD SPEC. FOR ACTION-PIN
 MATERIAL : GLASS-FIBER EPOXYDE
 (ie.NEMA GRADE G10)
 BOARD THICKNESS : 1.6~3.2mm
 PLATED-THROUGH HOLE SPEC. (φD)
 HOLE DIA AFTER DRILLING : 1.15±0.025
 Cu LAYER : 0.025~0.075
 TIN PL LAYER : 0.004~0.010
 HOLE DIA AFTER PLATING : 0.94~1.09
 FINISHED HOLE DIA AFTER
 TIN PL REFLOW : 0.91~1.09
- △ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

層	厚さ	材料	処理	穴径	位置	番号
1	0.4μ					1-
2	0.8μ					4-
3	0.2μ	金フラッシュ	Au FLASH PL.			3-
4	0.2μ					2-
5	0.2μ			16.2		1-
6	0.4μ					4-
7	0.8μ					2-
8	0.2μ	ニッケルめっき	Ni PL.	4.7		5174107-1

△ OBSOLETE

銅めっき Tin PL	銅めっき Tin PL (0.5~2.54μ)	金めっき Au PL (0.2μ)	ニッケルめっき Ni PL	下穴	位置	番号
TIN AREA	ACTION PIN AREA	CONTRACT CONTACT AREA	UNDER PL.	寸法	A	NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIM: T.KIMURA SONOV4
 CHK: K.KEGAMI SONOV4
 APD: K.KEGAMI SONOV4
 PRODUCT SPEC: 製品仕様
 APPLICATION SPEC: 動作仕様
 WEIGHT: 重量
 CUSTOMER DRAWING

TYCO Electronics
 Kawasaki, Japan

IEC CONN. TYPE C FEMALE ASSY (96 POS)

SIZE: A2
 CAGE CODE: 00779
 DRAWING NO: 5174107
 RESTRICTED TO: 1
 SHEET: 1 OF 1
 REV: 01